

中美科技战进入新阶段

双重喜庆

中美关系今年开年以来并未延续去年底紧张持续降温的势头。拜登政府过去一个月明显将施压中国的重点放在科技围堵，通过加大科技结盟及出口限制力度，制约中国芯片制造能力，使其被西方“掐脖子”难以突围。

拜登政府去年10月已单方面升级对中国的科技战，宣布全面的出口管制措施，希望拖慢中国军事和人工智能发展步伐。

对是否加入由美国主导围堵中国科技的联盟，芯片制造设备强国荷兰在过去一段时间里持续中立谨慎。荷兰外贸与发展合作部长施赖纳马赫尔今年1月中才表示，不会草率跟随美国对中国实施芯片出口制造技术新限制。

但上周五（1月27日）荷兰据称已与美国、日本达成协议，决定联手限制芯片技术输往中国，俨然形成围堵中国半导体发

展的三国联盟。事态发展速度之快，令外界颇感意外。

尽管荷兰为何选择此时与美日联手的原因暂不得而知，但日本和荷兰开年以来在军事安全领域实际上又已进一步靠向美国。

日本首相岸田文雄与荷兰首相吕特本月曾一前一后前往华盛顿，与美国总统拜登会谈。美日首脑会中不仅高调强化两国同盟关系，还发表联合声明批评中国的行为与基于规则的国际秩序不一致，导致亚太地区面临越来越多挑战。

吕特则向拜登表示在俄乌战场上跟随美国，也向乌克兰提供爱国者导弹防御系统，显然在俄乌战争及区域安全问题上与美国保持同调。这凸显荷兰在区域冲突中对俄罗斯的担忧，未采取与中国同样“劝和促谈”的立场。

由于安全上高度依赖美国，不难想

象，荷兰在面对拜登政府要求配合出口限制，不可能无限期维持中立并不断对美说不。

在美日首脑传出取得“非常有成效”的会谈后，吕特也松口表示取得逐步进展，为三国联盟埋下伏笔。

据目前有限的消息，荷兰将扩大限制光刻机巨头阿斯麦向中国销售最先进的极紫外光刻机；日本也将对尼康施行类似措施。

不过，美荷日却迟迟不愿公开证实结盟，也不愿多做评论或公开协议内容。吕特上周五仅称，新的半导体出口限制是“敏感课题”，即便有成果也不会对外公开太多。

岸田则未对三国结盟发表谈话，表明荷日两国可能都有

意保持低调，交给美国重大外交胜利的同时，也避免声张进一步开罪中国。

美国则拖到星期二，才由商务部副部长格雷夫斯出面发表简短评论，称正与荷日两国进行协商。

尽管外界普遍预期中国将反制美荷日，但中国外长秦刚本周仍不放弃外交游说，明显是希望在消息正式公开前仍有转圜，同时确保与荷兰的双边贸易仍有回旋空间。

秦刚星期一与荷兰副首相兼外长胡克斯特拉通电话，表示中国愿同荷兰共同维护国际产业链供应链稳定，维护开放而非分裂、有序而非混乱的国际贸易环境。

中国外交部发言人毛宁同日也避免指责荷日两国，仅点名批评美国滥用出口管

制，“胁迫诱拉一些国家”组建遏制中国的小圈子，将科技经贸问题政治化、武器化，破坏全球产供应链稳定。

上周五主导与荷日结盟的白宫国家安全顾问沙利文，星期二则继续与来访的印度国家安全顾问多瓦尔会面，正式启动美印“关键与新兴科技倡议”，在军事装备、半导体、人工智能等领域强化双边合作，以民主为号召组建高科技联盟对抗中国。

美国明显是在利用中印长久以来悬而未决的边境矛盾，强调中国威胁，以拉近与印度的距离，也旨在扭转印度长年对俄罗斯军事设备的依赖，转向加强美印军事及科技联系。

除了计划在南亚部署更多西方的手机网络以抗衡中国华为，美国商务部星期二传出将大幅收紧对中国这家电讯巨头的出口限制，计划将4G、WiFi 6无线网络等低于5G等级的产品纳入禁令范围。

显而易见，美国对华发动的科技战已进入新阶段，通过进一步加强军事科技纽带，让盟友转向更依赖美国，更难拒绝加入科技围堵中国的联盟。中美之间为此展开的攻防，也必然将是今年双边关系的重要观察点之一。

来源：联合早报



日本首相岸田文雄与美国总统拜登举行会谈

